三星最新產品於 CES 2027 展前獲美國消費技術協會肯定

行動裝置、家庭娛樂、家電及半導體產品榮獲 CES® 2027 創新獎肯定

Galaxy Z Fold8 Ultra 與 Z Fold8 雙雙榮獲行動裝置類別「CES 創新獎最佳創新獎」



全球科技領導品牌三星電子宣布，旗下多款產品與服務於 CES 創新獎®(CES Innovation Awards®)2027 評選中獲得美國消費技術協會（CTA）® 肯定，奪得「最佳創新獎（Best of Innovation）」產品數量更較 2026 年翻倍成長。

CES 創新獎旨在表彰橫跨多元消費性科技領域的卓越設計與工程技術。對三星而言，這份殊榮印證了品牌致力打造無縫串聯生態圈的願景，讓日常使用更便利、更具創造力且更貼近人心；同時也突顯三星在 AI 整合、沉浸式顯示技術、智慧家庭解決方案，以及驅動次世代裝置的先進半導體技術上的深耕成果。

其中，三星影像顯示（VD）事業部憑藉最新的顯示與音訊創新技術大放異彩，共有兩款產品拿下 CES 創新獎「最佳創新獎」，另有多項產品與功能獲選為 CES 創新獎獲獎產品（Honorees）。數位家電（DA）事業部亦因推出提升日常便利性、效率與實用機能的家電創新而備受肯定，其中包括升級版 Bespoke AI Laundry Combo，該系列初代機型於 2024 年獲獎後，今年再度榮獲 CES 創新獎肯定。

從延續摺疊螢幕手機的經典工藝，到推進融入日常的智慧 AI 解決方案，這一系列獎項展現了三星持續創新的承諾，致力打造更互聯、更個人化的未來生活，讓科技裝置在日常背後默默運作、無感融入生活。三星完整獲獎產品名單將於 2027 年 1 月 4 日正式公布。

全球突破性科技與設計的指標盛會 CES 2027 將於 1 月 6 日至 9 日在美國內華達州拉斯維加斯登場，屆時將讓與會者搶先一睹三星新世代創新技術的風采。

CES 2027 創新獎「最佳創新獎」得主精彩亮點

行動裝置、配件與應用程式類別：Galaxy Z Fold8 Ultra

「Ultra」代表 Galaxy 系列在效能、實力與創新的最高標準，而 Galaxy Z Fold8 Ultra 將此極致標準與三星最先進的摺疊設計完美融合。展開後寬廣的 8 吋內頁螢幕，為多工處理開創高效行動工作空間。儘管它是三星史上最輕薄的 Z Fold 機種 - 展開厚度僅 4.1mm、重量僅 215 公克，卻配備歷代 Z Fold 系列最大容量的 5,000mAh 電池，大幅延長續航時間，讓使用者在更輕薄的摺疊機身中，從容應付全天候的工作、創作與娛樂需求。

此外，新機採用 Flex Titanium 技術螢幕架構，透過雙層鈦金屬材質強化耐用度，同時使螢幕模組厚度減少 10%，不僅為內部零組件騰出更多空間，並讓螢幕表面更平整、摺痕大幅淡化。相機規格方面，2 億畫素廣角鏡頭支援全解析度 HDR 拍攝；全新 5,000 萬畫素超廣角鏡頭取代前代 Z Fold7 的 1,200 萬畫素鏡頭，不僅新增微距拍攝功能，更搭配更大的 F1.9 光圈，進光量提升約 34%。無論進行多工處理或影像創作，Galaxy Z Fold8 Ultra 都能帶來無與倫比的使用體驗。

行動裝置、配件與應用程式類別：Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 為渴望在靈感乍現、探索深入知識的瞬間，擁有自然流暢摺疊體驗的使用者重新打造。身為三星史上最輕盈的 Galaxy Z Fold，Galaxy Z Fold8 有別於主打極致生產力的 Galaxy Z Fold8 Ultra，開創全新摺疊機身比例。其 5.5 吋封面螢幕採用 10:16 比例，最適合滑動瀏覽網頁、傳送訊息與觀看短影音；展開後的 7.6 吋 4:3 內頁主螢幕，則為暢打手遊、觀賞影音提供更寬闊的視野，並支援畫面與留言區並排顯示。

機身結構採用結合精密鈦金屬板與超薄鈦合金薄膜的 Flex Titanium 技術，在縮減螢幕模組厚度的同時，兼顧反覆開合的耐用性、抗衝擊緩衝能力，並有效降低螢幕摺痕。相機方面，配備 5,000 萬畫素廣角與超廣角雙鏡頭，最高支援 8K 錄影；「雙向錄影」功能更可透過無裁切分割畫面，同步捕捉前後鏡頭視角。

CES 2027 創新獎「獲獎產品」精彩亮點

電腦硬體與零組件類別：512GB DDR5 RDIMM（採用 1b 製程 32Gb DRAM）

三星 512GB DDR5 RDIMM 是專為高效能運算（HPC）與次世代資料中心設計的高容量伺服器記憶體模組，採用先進 32Gb DRAM 技術打造。相較於傳統 16Gb DRAM 模組需採用 8 層堆疊，此款新品憑藉 32Gb DRAM 僅需 4 層堆疊結構即可實現 512GB 容量，簡化的設計不僅降低封裝複雜度，更提供更高的系統設計彈性。在具備 16 條記憶體通道的伺服器中[註一]，配置 512GB RDIMM 最高可提供 8TB 記憶體容量，是 256GB RDIMM 最高 4TB 容量的兩倍；同時，功耗較傳統 16Gb DRAM 512GB RDIMM 降低高達 15%，有助於減少資料中心的電力消耗與散熱需求。此外，該模組能高效支援生成式 AI 訓練、機器學習與企業大數據分析等記憶體密集型工作負載，進一步提升資料中心營運效率，並降低總持有成本（TCO）[註二]。

電腦硬體與零組件類別：LPDDR5X SOCAMM2

三星 LPDDR5X SOCAMM2 是專為 AI 伺服器打造的精巧型記憶體模組，結合低功耗行動版 DRAM 的節能優勢與超高頻寬，足以應付嚴苛的 AI 運算負載。其頻寬高達 153.6 GBps，為傳統 DDR5 RDIMM 的 2.6 倍，能源效率更提升超過 70%，讓 AI 伺服器能以更低功耗實現更快速的資料處理。模組採用低高度水平設計，可節省伺服器內部空間並最佳化氣流循環，進而提升散熱效率；可拆卸式模組設計則讓使用者無需更換主機板，即可輕鬆替換記憶體或升級容量，使維護作業更簡便且具彈性。結合高頻寬、高能效與靈活設計，LPDDR5X SOCAMM2 協助資料中心建構更高效、更具擴充性的 AI 伺服器系統。

行動裝置、配件與應用程式類別：UFS 5.0

三星 UFS 5.0 是業界首款專為智慧型手機與各類行動裝置新世代智慧終端 AI(On-device AI)設計的 UFS 5.0 儲存解決方案。隨著生成式 AI 與代理型 AI（Agentic AI）應用程式直接在裝置端處理日益龐大的資料，更快速、更節能的儲存技術已成為關鍵。UFS 5.0 提供高達 10.8 GBps 的頻寬，循序讀寫效能達到 UFS 4.1 的兩倍；搭配三星獨家軟體演算法，更將大容量儲存區域的隨機讀取效能提升超過 3.4 倍。這些技術突破大幅縮短 AI 模型載入時間並提升系統反應速度，為即時內容生成等 AI 功能提供強大後盾。UFS 5.0 提供 512GB 與 1TB 兩種容量選擇，封裝尺寸較前一代縮小 16.7%，為電池等核心零組件釋出更多內部空間，提升機身設計彈性；同時能源效率較 UFS 4.1 提升 40%，有助於降低執行高負載 AI 任務時的電池耗電量。

註一：採用每通道單一記憶體模組（1DPC）配置運作。

註二：總營運成本。